

MPI TS3000-DS | 300 mm オートマチック・プローブシステム

CPOおよびCOUPE*デバイス特性評価に対応した、片面および両面对応のEIC-PIC (EPIC) ウェハ・プローブシステム

顕微鏡および 光学系オプション

- 50 × 50 × 140 mm のプログラム可能な動作範囲を備えた、安定した顕微鏡ブリッジマウント
- MPI AMZ12 (最大12倍の光学ズーム) やデジタル顕微鏡 MPI iMAG® など、さまざまな顕微鏡オプションを用意
- 垂直プローブカード用のプローブパッド位置合わせ (PTPA)

光学系セットアップ

- Hexapod+NanoPositioner の組み合わせ
- 垂直、水平、およびトレンチ・カップリング
- 東、西、または東西の構成
- 上面または裏面の構成

電気系セットアップ

- 4.5 インチ・プローブカード(丸形、角型)
- DC およびRF マイクロポジショナ
- 上面構成
- 最大35kg荷重に対応する、高ピン数対応 (オプション)

マイクロポジショナ

- RF用最大4台、DC用最大10台のマイクロポジショナに対応
- 種々のマイクロポジショナを用意
- 同軸、トライアキシャルおよびケルビン用の専用プローブアーム

上部プローブプラテン

- 高い安定性と剛性を備えた設計
- RFポジショナ用の矩形方向調整機構
- 最大の熱安定性を実現するための空冷機構を内蔵

裏面プローブプラテン

- Hexapod+NanoPositioner 用
- 接触・分離動作のためのZ軸移動機構内蔵

一体型防振テーブル

- 高性能防振プラットフォームを搭載
- 人間工学に基づいた最適な作業高さ



ソフトウェアスイート SENTIO® (Windows 11対応)

- マルチタッチ操作による簡単で直感的な操作性により、トレーニング時間を最小限に
- モバイルデバイスに類似したナビゲーションにより、操作が容易
- アクティブなアプリケーションと他のアプリの切り替えは、指でスワイプするだけで簡単に実施
- QAlibria® によるRF校正機能を統合
- リモート制御のための GPIB および TCP/IP インターフェース
- 完全統合された両面光学テスト・プロセス

SiPh校正エリア

- 上面および裏面に2つの校正エリアを配置
- ファイバーの高さおよび回転角度の調整
- 統合された温度補償校正
- 最高レベルのアライメント精度を提供

ハードウェア統合制御パネル

- 高速、安全かつ直接的なシステム制御の実現
- キーボードおよびマウスを障害物なく配置可能

GridChuck™

- 300 mm ウェハ、ウェハ片、および個片化されたダイに対応
- 上部からの電気プロービングおよび/または裏面からの光学プロービング用に設計
- ウェハレイアウトに対応したカスタマイズ可能な裏面開口部
- 絶縁型バナナコネクタによるチャック接続

温度チャック統合

- タッチスクリーンによる温度 GridChuck™ の制御
- オペレーターが前面から容易にアクセス可能
- 室温から150℃までの温度対応

*COUPE™ は Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) の商標です。